

3-827314-6 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 3-827314-6

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 36 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Breakaway, Tin, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 36

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	垂直
连接器端子负载状态	满载
位数	36
行数	1
PCB 安装方向	直角

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压 (最大值)	750 Vrms

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------



端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[118.11 μin]
端子形状和构造	正方形
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A
端接特性	
方形端接柱体和尾部尺寸	.63 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
壳体特性	
外壳材料	PCT
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
使用环境	
壳体温度额定值	标准
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
操作/应用	
焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
其他	
已忽略的装载位置	0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



客户还购买了



文档

产品图纸

[36P MOD2 STIFT LEI](#)

英文版本

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnection System](#)

[AMPMODU Interconnection System](#)

英文版本